



Electronics for the Future

決算発表 補足資料

2022年度 第3四半期決算

2023年2月2日
ローム株式会社
IR室

2022年度 第3四半期 実績 業績報告 (前年同期比)

(単位：億円)

	FY2022 第3四半期 実績	FY2021 第3四半期 実績	増減額	増減率
売上高	1,302	1,155	+147	+12.7%
営業利益	250	216	+34	+15.3%
(対売上比率)	(19.2%)	(18.8%)	-	-
経常利益	196	239	▲43	▲18.1%
(対売上比率)	(15.1%)	(20.7%)	-	-
純利益	158	176	▲18	▲10.2%
(対売上比率)	(12.1%)	(15.2%)	-	-
EBITDA	400	321	+79	+24.4%
(対売上比率)	(30.7%)	(27.9%)	-	-

期中平均レート(¥/US\$) (141.16円) (113.60円)

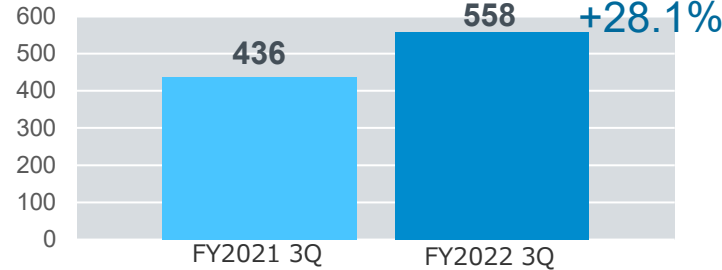
期末レート(¥/US\$) (132.70円) (115.02円)

(単位：億円)

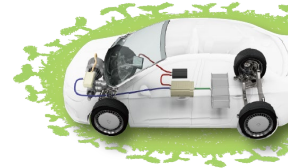
四半期売上高

1,155億円 **+12.7%**
1,302億円
 FY2021 第3四半期実績 FY2022 第3四半期実績

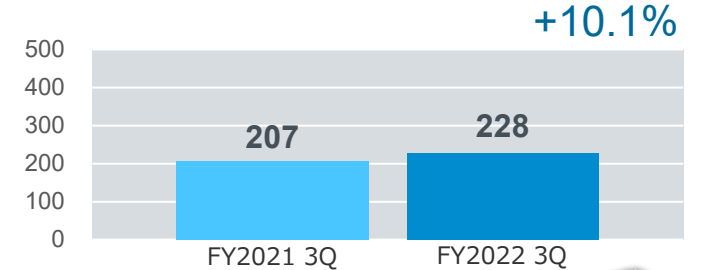
自動車



- インフォテインメント分野 +36
- ボディ分野 +14
- パワートレイン分野 +8
- 安全走行ADAS分野 +9
- xEV分野 +48
- その他 +8



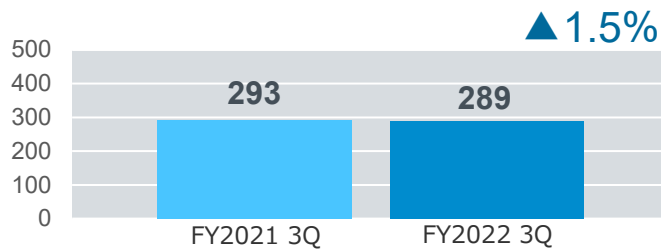
産機



- FA分野 +0
- エネルギー分野 +17
- ホームビルディング分野 +1
- その他 +3



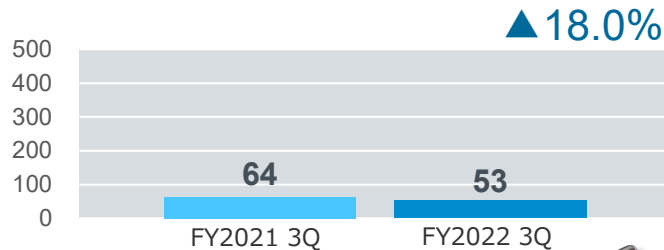
民生



- AV関連 ▲2
- 家電分野 ▲1
- その他 ▲2



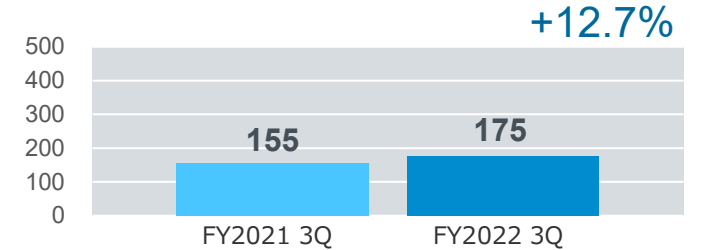
通信



- スマホ&モバイル分野 ▲14
- 基地局&インフラ分野 +3
- 有線通信分野 ▲0



コンピュータ & ストレージ

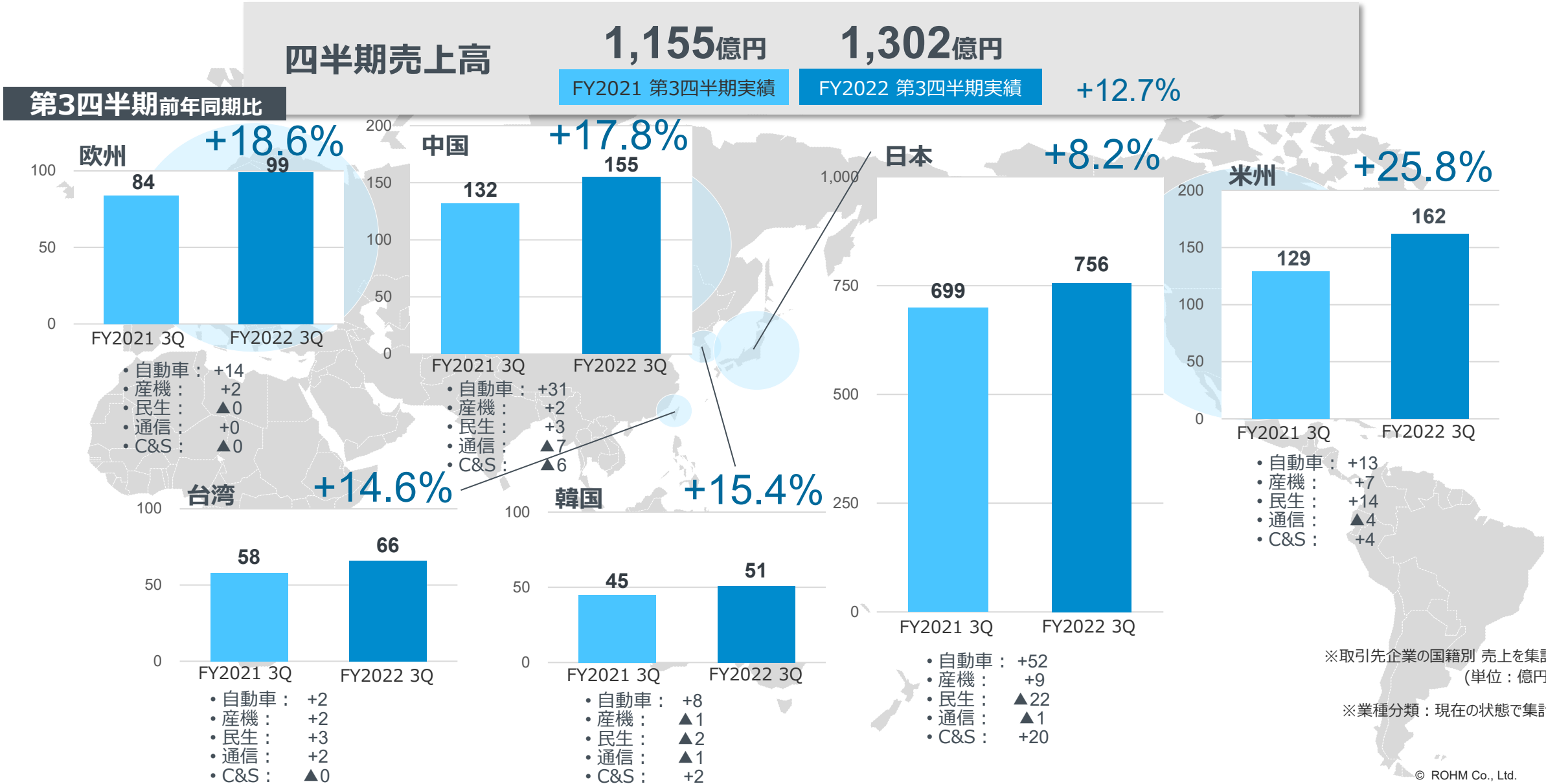


- PC&サーバー分野 +5
- 決裁端末向け ▲5
- 事務機分野 +20

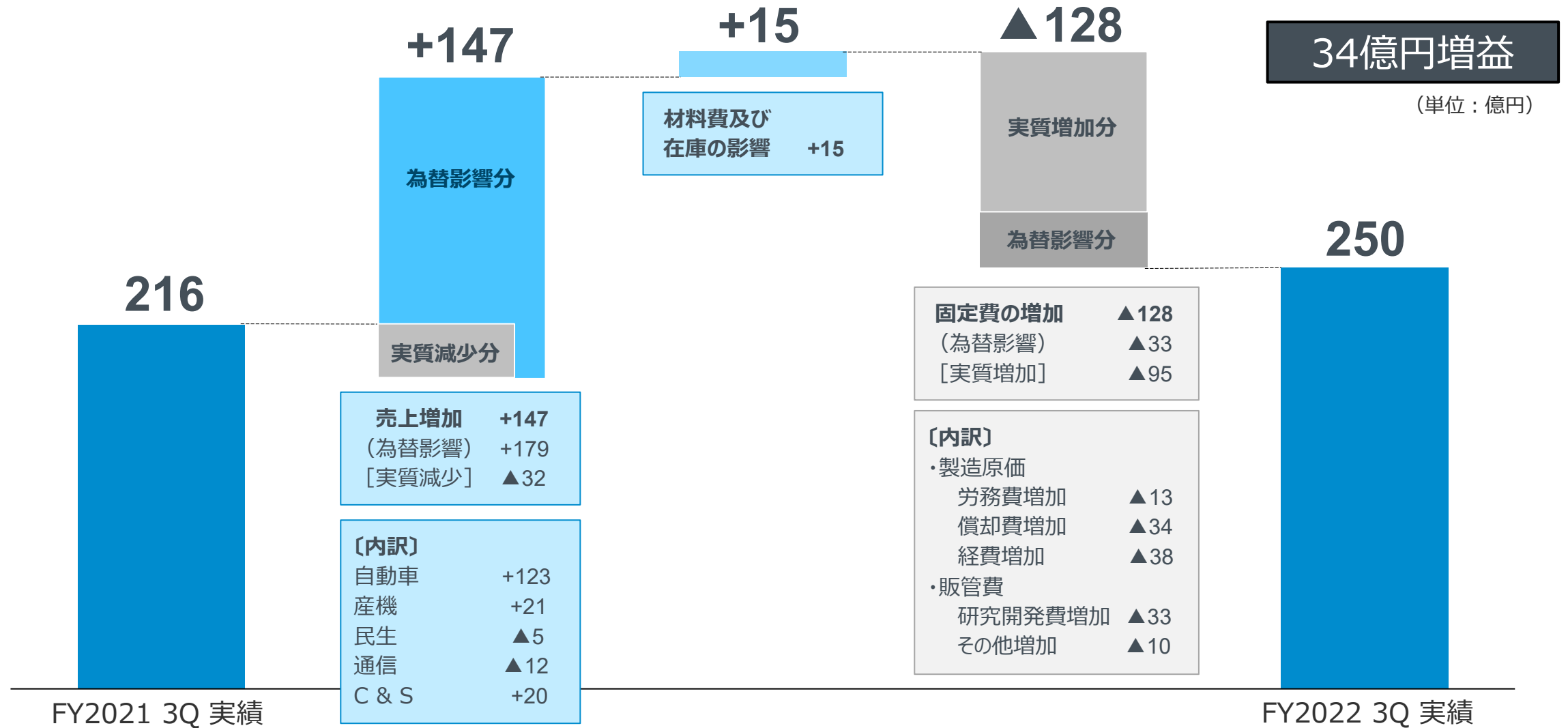


※業種分類：現在の状態で集計

2022年度 第3四半期 国籍別 売上の変動要因 (前年同期比)



2022年度 第3四半期 営業利益 増減分析 (前年同期比)



期中平均レート
(¥/US\$)

(113.60円)

(141.16円)

2022年度 第3四半期 セグメント別 (前年同期比)

(単位：億円)

		FY2022 第3四半期 実績	FY2021 第3四半期 実績	増減額	増減率
LSI	売上	615	532	+83	+15.7%
	セグメント利益	143	105	+38	+36.3%
	(利益率)	(23.3%)	(19.8%)	-	-
半導体素子	売上	538	470	+68	+14.5%
	セグメント利益	92	92	+0	+0.2%
	(利益率)	(17.2%)	(19.6%)	-	-
モジュール	売上	83	84	▲1	▲1.4%
	セグメント利益	11	14	▲3	▲18.9%
	(利益率)	(14.0%)	(17.0%)	-	-
その他	売上	64	68	▲4	▲5.1%
	セグメント利益	10	12	▲2	▲10.8%
	(利益率)	(16.6%)	(17.7%)	-	-

2022年度 第3四半期 実績 業績報告 (直前四半期比)

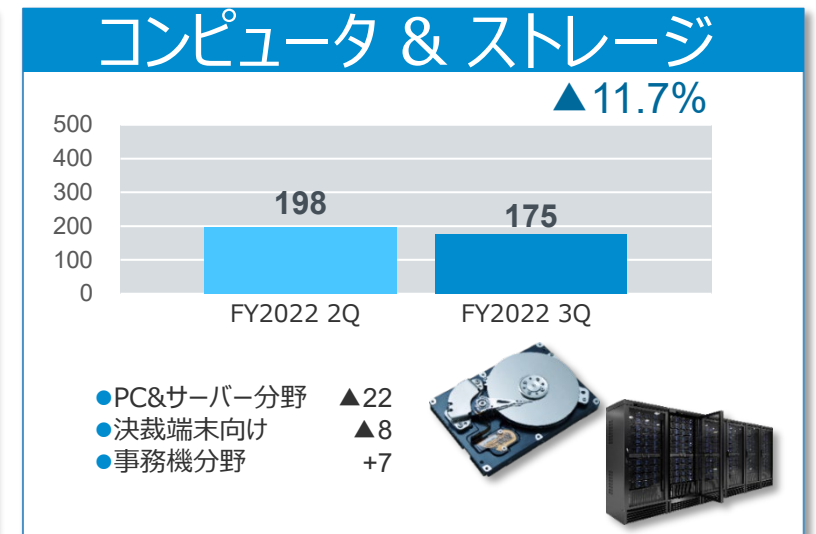
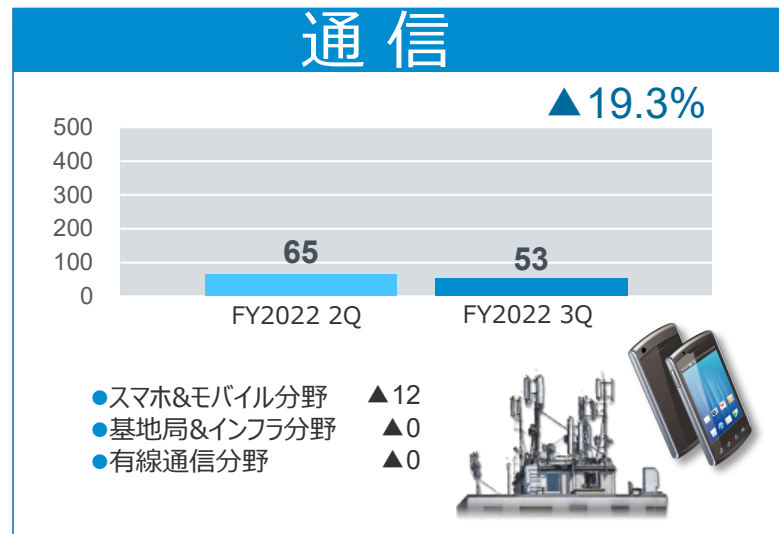
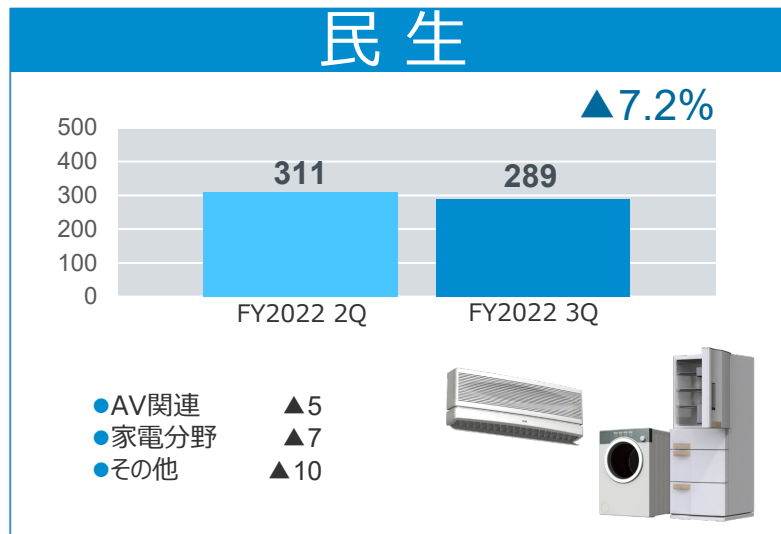
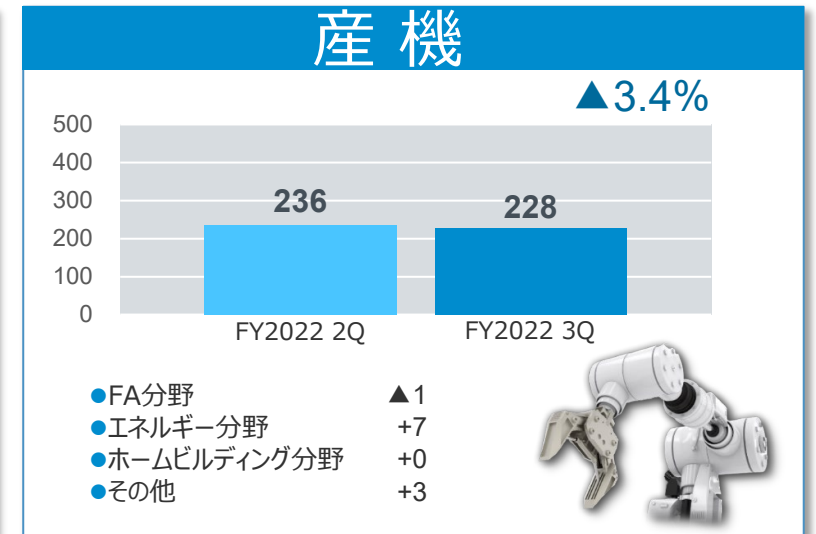
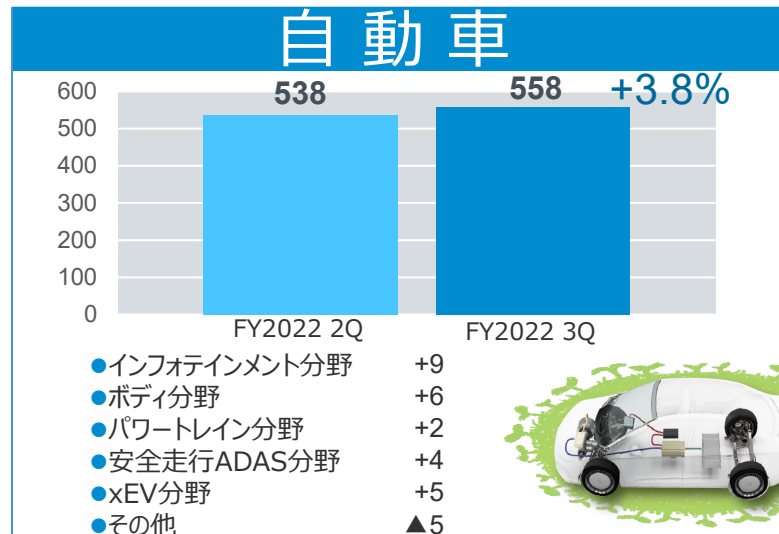
(単位：億円)

	FY2022 第3四半期 実績	FY2022 第2四半期 実績	増減額	増減率
売上高	1,302	1,347	▲45	▲3.4%
営業利益	250	278	▲28	▲10.3%
(対売上比率)	(19.2%)	(20.7%)	-	-
経常利益	196	356	▲160	▲45.0%
(対売上比率)	(15.1%)	(26.4%)	-	-
純利益	158	260	▲102	▲39.2%
(対売上比率)	(12.1%)	(19.3%)	-	-
EBITDA	400	411	▲11	▲2.6%
(対売上比率)	(30.7%)	(30.5%)	-	-

期中平均レート(¥/US\$) (141.16円) (138.68円)

期末レート(¥/US\$) (132.70円) (144.81円)

(単位：億円)



※業種分類：現在の状態で集計

2022年度 第3四半期 国籍別 売上の変動要因 (直前四半期比)

四半期売上高

1,347億円

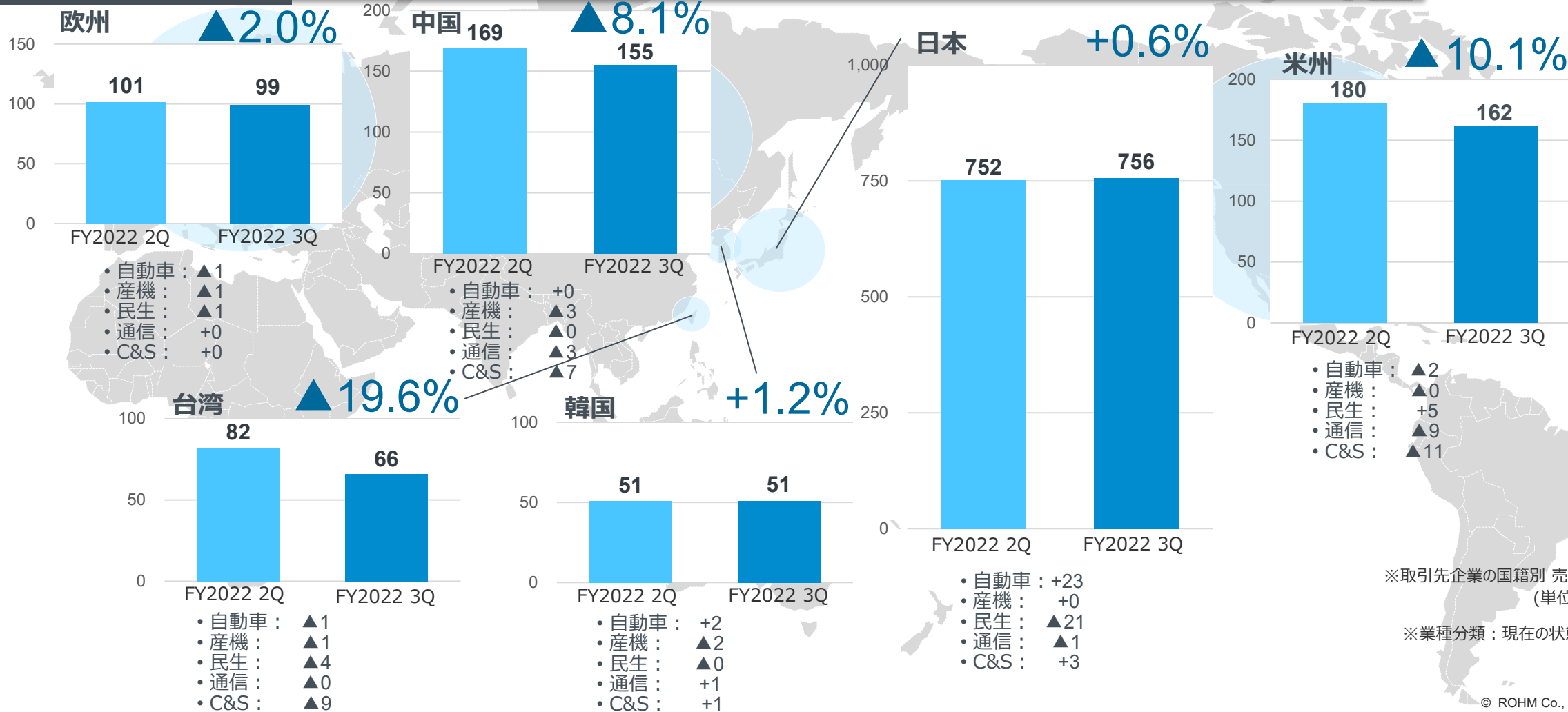
1,302億円

FY2022 第2四半期実績

FY2022 第3四半期実績

▲3.4%

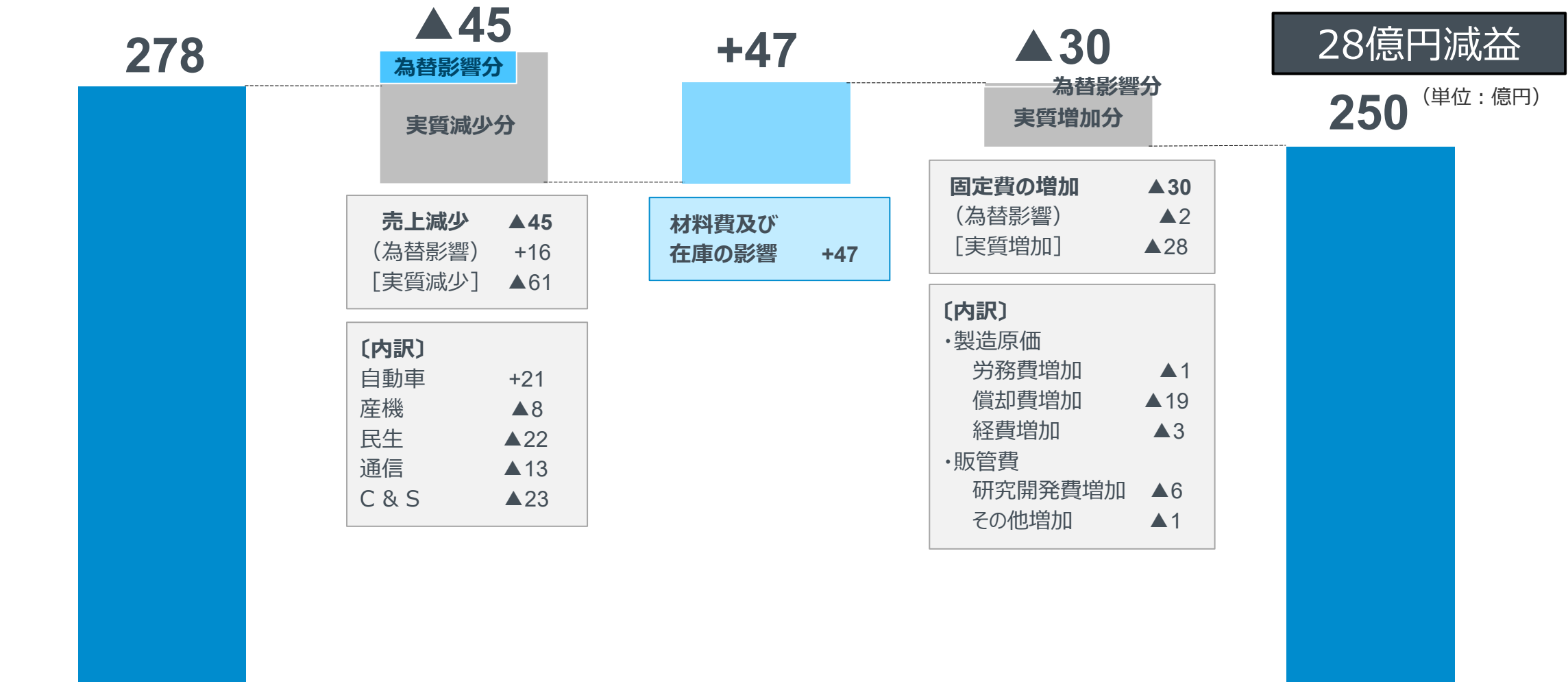
第3四半期直前四半期比



※取引先企業の国籍別 売上を集計 (単位: 億円)

※業種分類: 現在の状態で集計

2022年度 第3四半期 営業利益 増減分析 (直前四半期比)



28億円減益

250 (単位：億円)

FY2022 2Q 実績

FY2022 3Q 実績

(138.68円)

(141.16円)

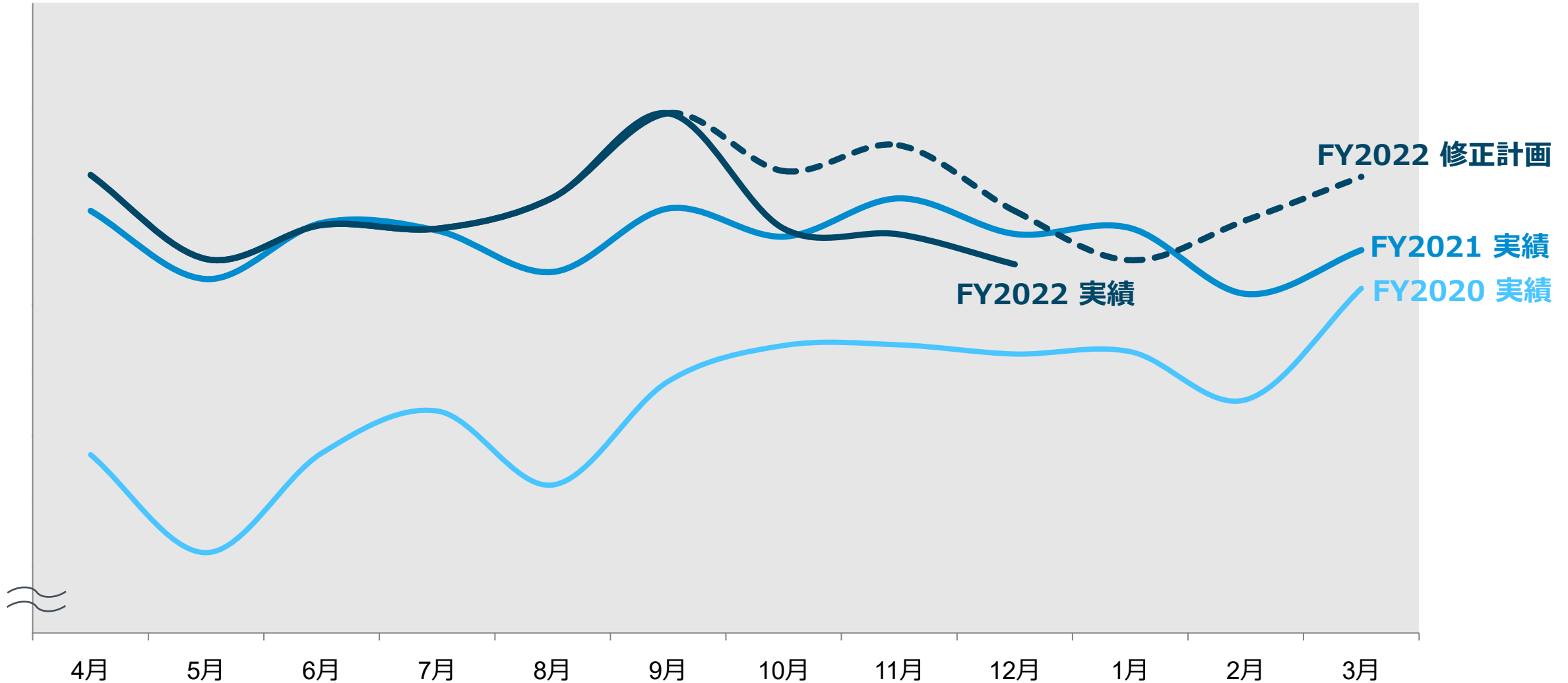
期中平均レート
(¥/US\$)

2022年度 第3四半期 セグメント別 (直前四半期比)

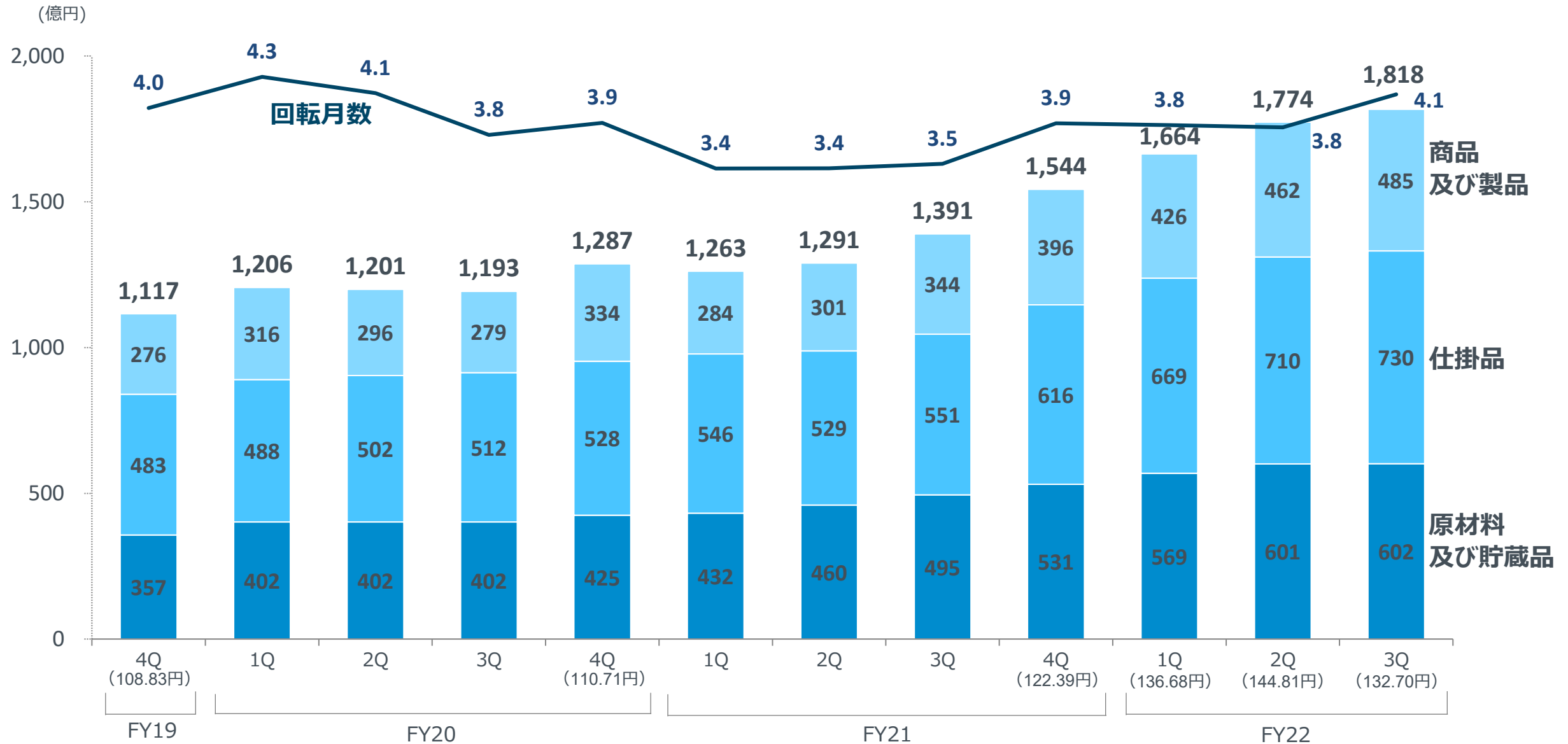
(単位：億円)

		FY2022 第3四半期 実績	FY2022 第2四半期 実績	増減額	増減率
LSI	売上	615	622	▲7	▲1.2%
	セグメント利益	143	151	▲8	▲5.6%
	(利益率)	(23.3%)	(24.4%)	-	-
半導体素子	売上	538	558	▲20	▲3.6%
	セグメント利益	92	100	▲8	▲7.6%
	(利益率)	(17.2%)	(17.9%)	-	-
モジュール	売上	83	92	▲9	▲10.0%
	セグメント利益	11	14	▲3	▲18.5%
	(利益率)	(14.0%)	(15.5%)	-	-
その他	売上	64	74	▲10	▲12.5%
	セグメント利益	10	17	▲7	▲36.9%
	(利益率)	(16.6%)	(23.1%)	-	-

※為替は1USD = 105円で換算



在庫の状況 (金額)



通期の業績予想について

【ご参考】 2022年11月1日公表 修正計画値

(単位：億円)

	FY2022 修正計画	FY2021 実績	増減額	増減率
売上高	5,200	4,521	+679	+15.0%
営業利益	900	714	+186	+25.9%
(対売上比率)	(17.3%)	(15.8%)	-	-
経常利益	1,050	825	+225	+27.2%
(対売上比率)	(20.2%)	(18.3%)	-	-
純利益	800	668	+132	+19.7%
(対売上比率)	(15.4%)	(14.7%)	-	-
EBITDA	1,485	1,135	+350	+30.8%
(対売上比率)	(28.6%)	(25.1%)	-	-

期中平均レート(¥/US\$) (134.17円) (112.86円)

期末レート(¥/US\$) (135.00円) (122.39円)

Question	Answer
3Qまでにおける能力増強の結果は？	22/3期末から、23/3期末までに、10%の能力増強を計画しており、概ね順調に進んでおります。
稼働率の状況は？ 今後の在庫レベルは？	一部生産調整しているものもありますが、全体としては高い稼働率を維持しております。ひっ迫により十分に在庫が積めていない製品があり、引き続きBCP在庫の積み増しを行ってまいります。
製品の中で、ひっ迫が続いている製品、 余ってきている製品は？	半導体の中で、ロームの主力であるパワー・アナログ半導体はまだまだ不足感があります。一部小信号デバイスなどの汎用品については調整傾向ですが、全体としてはひっ迫状況が続いているため、お客様への供給責任を果たすために積極的に能力増強を進めてまいります。
値上の効果はどのくらいあったのか？	具体的な金額はお伝えできませんが、想定通りの効果が出ているとみています。
3Q末の受注残高は？	民生や通信、PC市場向けにおいて足元の需要は落ちていますが、自動車市場向けの増加で全体としては、2Q末から大きな変動はありません。
足元の需要動向は？ 来期の市場別の見通しは？	民生や通信、PC市場向けにおいて調整傾向ですが、自動車市場向けについては順調に推移するものと思われます。来期以降においても、自動車市場向けにつきましては、自動車生産台数の回復やコンテンツの増加で更なる成長を期待しております。
来期の設備投資の水準は？	パワー・アナログ向けを中心に1,000～1,200億円規模の投資を検討しております。来年度においても年間で全体の生産能力10%増を目指します。
為替感応度は？	ドルに対して円安に動くと、業績にはプラスに働きます。 1円動くと、年間ベースで売上高26億円、営業利益8億円変動します。

- [2022-11-10 小型サイズで業界トップクラスの低電力損失！独自の絶縁構造で、小型機器の高効率化と安全動作に貢献するMOSFETを開発](#)
- [2022-11-15 BASiC Semiconductor とローム、戦略的パートナーシップ契約を締結](#)
- [2022-11-17 xEV向けアプリケーションの小型化とノイズ設計工数の削減に貢献する絶縁型DC-DCコンバータ「BD7Fx05EFJ-C」を開発](#)
- [2022-11-22 マツダ及び今仙電機と、SiCパワーモジュールを活用したe-Axle向けインバータの共同開発契約を締結](#)
- [2022-11-24 独自の回路・デバイス技術「TDACC™」で、安全動作と電力損失低減に貢献する小型インテリジェントパワーデバイスを開発](#)
- [2022-12-13 ロームの第4世代SiC MOSFETが日立Astemoの電気自動車用インバータに採用](#)
- [2022-12-15 工場や物流倉庫における設備管理・状態監視のメンテナンスフリー化に貢献する、電池不要な静電容量センサ内蔵のRFID通信LSI「MR793200」を開発](#)
- [2022-12-20 高い出力電圧安定性を持つ、冗長電源に最適な小型プライマリLDOを開発](#)



Electronics for the Future